

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2024年12月期第2四半期

2024年8月19日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



INDEX

目次



1. 2024年12月期第2四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 新技術紹介
5. 補足資料



1

2024年12月期第2四半期 連結業績

売上高

16,239百万円

営業利益

2,836百万円

経常利益

2,981百万円

親会社株主に帰属
する中間純利益

2,067百万円

■ 概況

- 第1四半期で遅れていた売上計上も順調に進み、売上高は計画比で若干の未達ではあったが概ね計画通りで推移。
- 減価償却費の減少、研究開発の進捗の遅れ等により販管費が想定より減少したことにより利益が計画比で上振れ。

	(百万円)	2024年12月期 Q2		前年同期比 増減率(%)	2024年12月期 計画	進捗率(%)
		2023年12月期 Q2 実績	実績 売上比(%)			
売上高	10,434	16,239	—	55.6	36,000	45.1
売上総利益	2,862	5,534	34.1	93.3	—	—
営業利益	539	2,836	17.5	426.1	4,600	61.7
経常利益	706	2,981	18.4	322.2	4,500	66.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	137	2,067	12.7	1,408.7	3,060	67.5

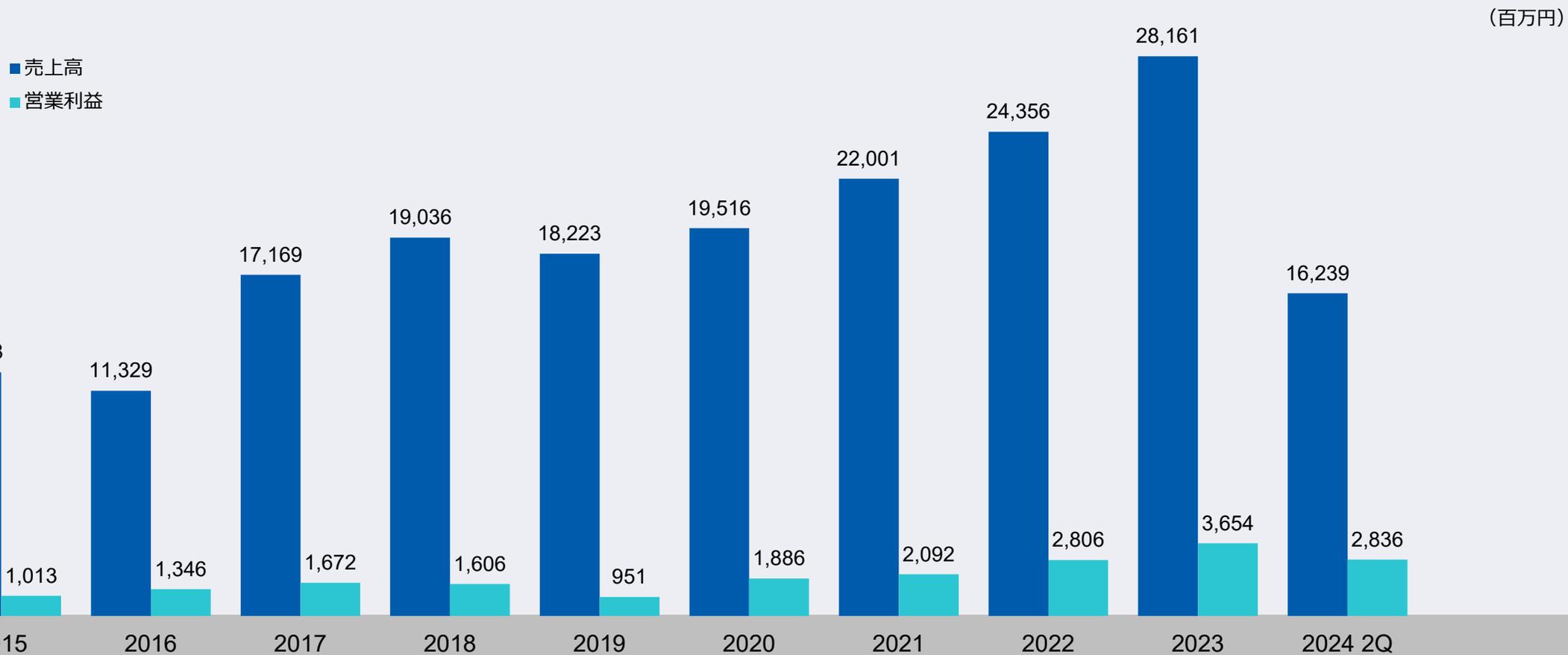
連結売上高・連結営業利益推移（四半期）

(百万円)

■ 売上高
■ 営業利益



連結売上高・連結営業利益推移



(百万円)	2023年12月期	2024年12月期 Q2	前期末比 増減率(%)
流動資産	39,420	42,296	7.3
固定資産	8,008	8,239	2.9
有形固定資産	7,007	7,275	3.8
無形固定資産	157	136	△13.4
投資その他資産	842	827	△1.8
総資産合計	47,428	50,536	6.6
流動負債	21,380	19,728	△7.7
固定負債	5,952	8,180	37.4
負債合計	27,333	27,908	2.1
純資産合計	20,095	22,627	12.6
自己資本比率	41.7%	44.0%	2.3P

主な増減要因

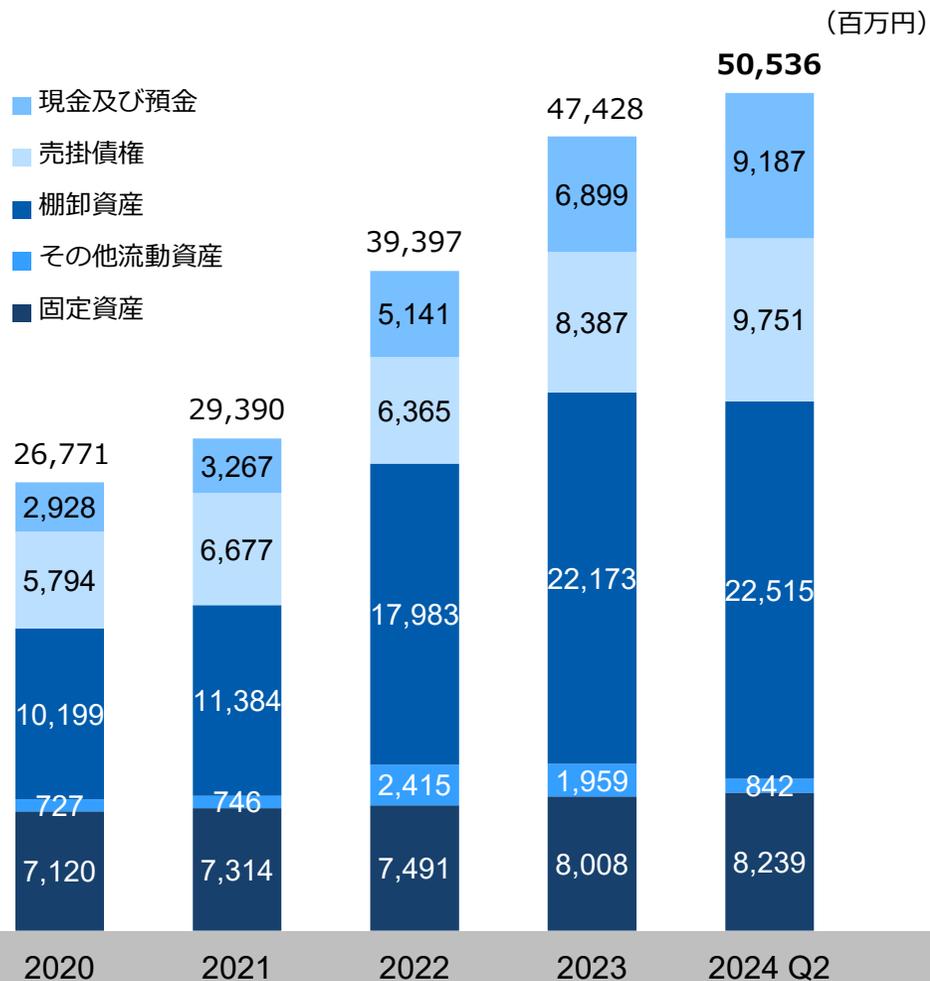
流動資産	(百万円)
現金及び預金	+2,287
電子記録債権	+1,723
流動負債	
契約負債	+3,682
電子記録債務	△1,387
短期借入金	△3,698
固定負債	
長期借入金	+2,174

(百万円)	2023年12月期	2024年12月期 Q2	前期比 増減率(%)
営業活動による キャッシュ・フロー	△261	4,353	—
投資活動による キャッシュ・フロー	△1,392	△971	△30.2
フリー・キャッシュ・ フロー	△1,653	3,382	—
財務活動による キャッシュ・フロー	3,275	△1,927	—
現金及び現金同等物の 期末残高	6,771	8,589	26.8

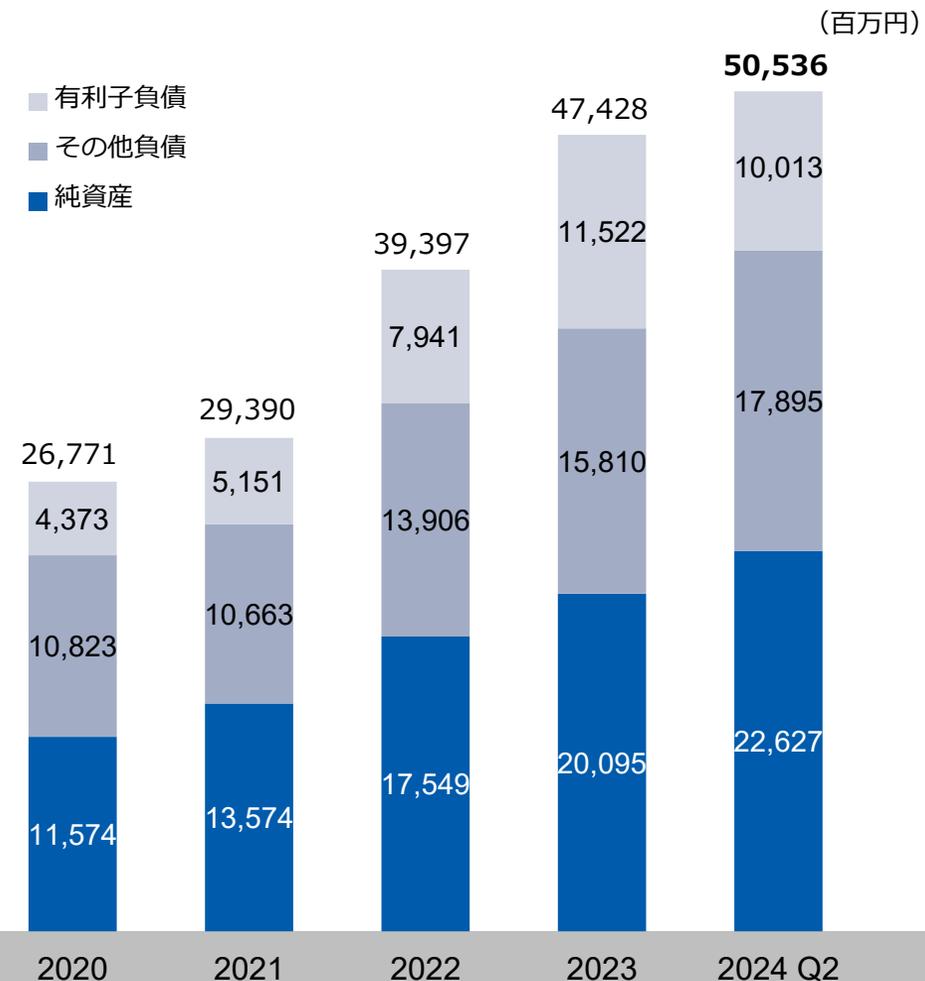
主な内訳

■ 営業CF		(百万円)
税金等調整前当期純利益		2,841
仕入債務の増加額		△1,710
契約負債の増加額		3,544
■ 投資CF		
定期預金の純増減額		△446
有形固定資産の取得による支出		△508
■ 財務CF		
短期借入金の増減額		△4,400
長期借入れによる収入		4,200
長期借入金の返済		△1,323

資産



負債／純資産





2

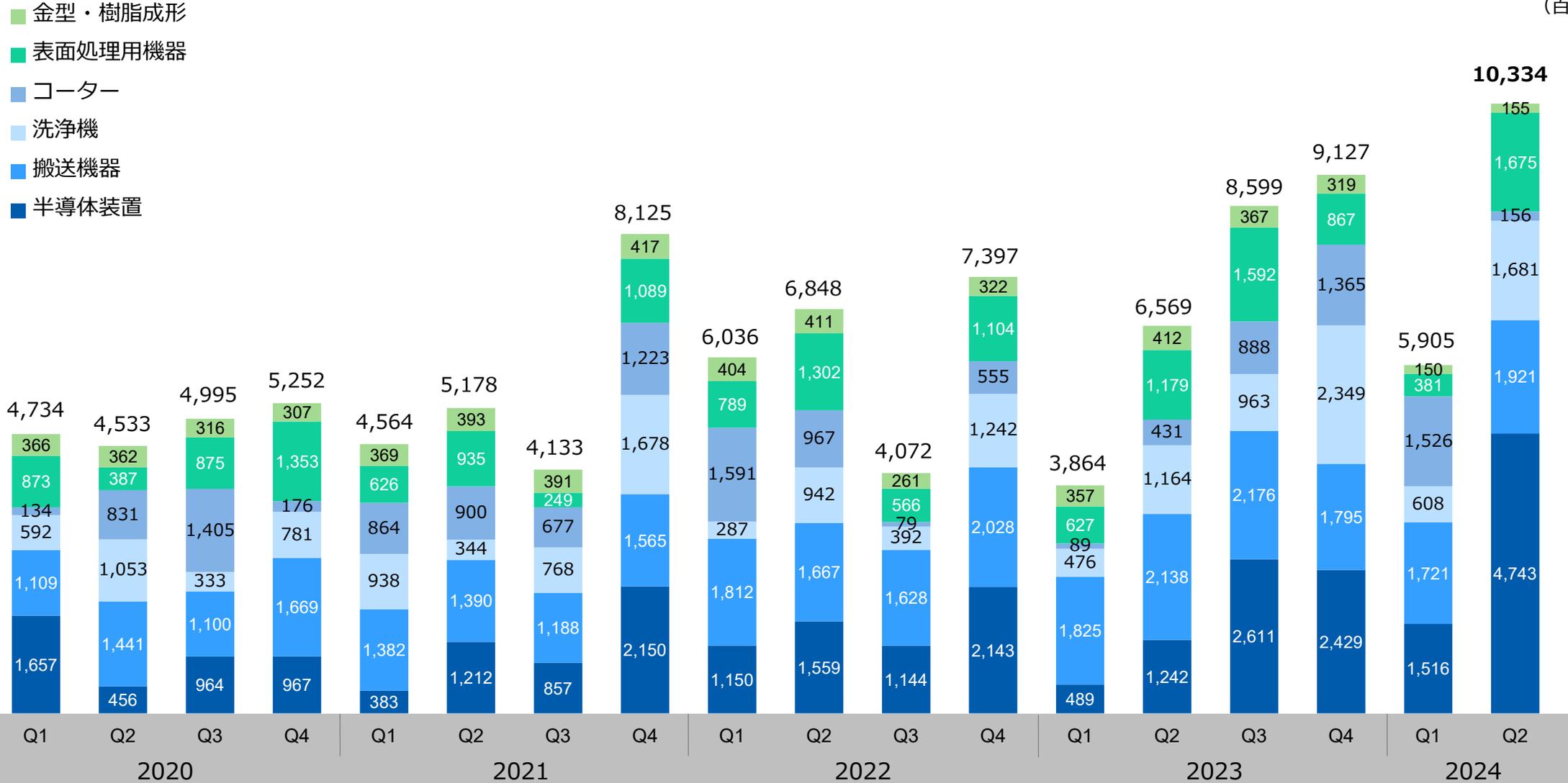
セグメント情報

2024年12月期第2四半期 セグメント別業績

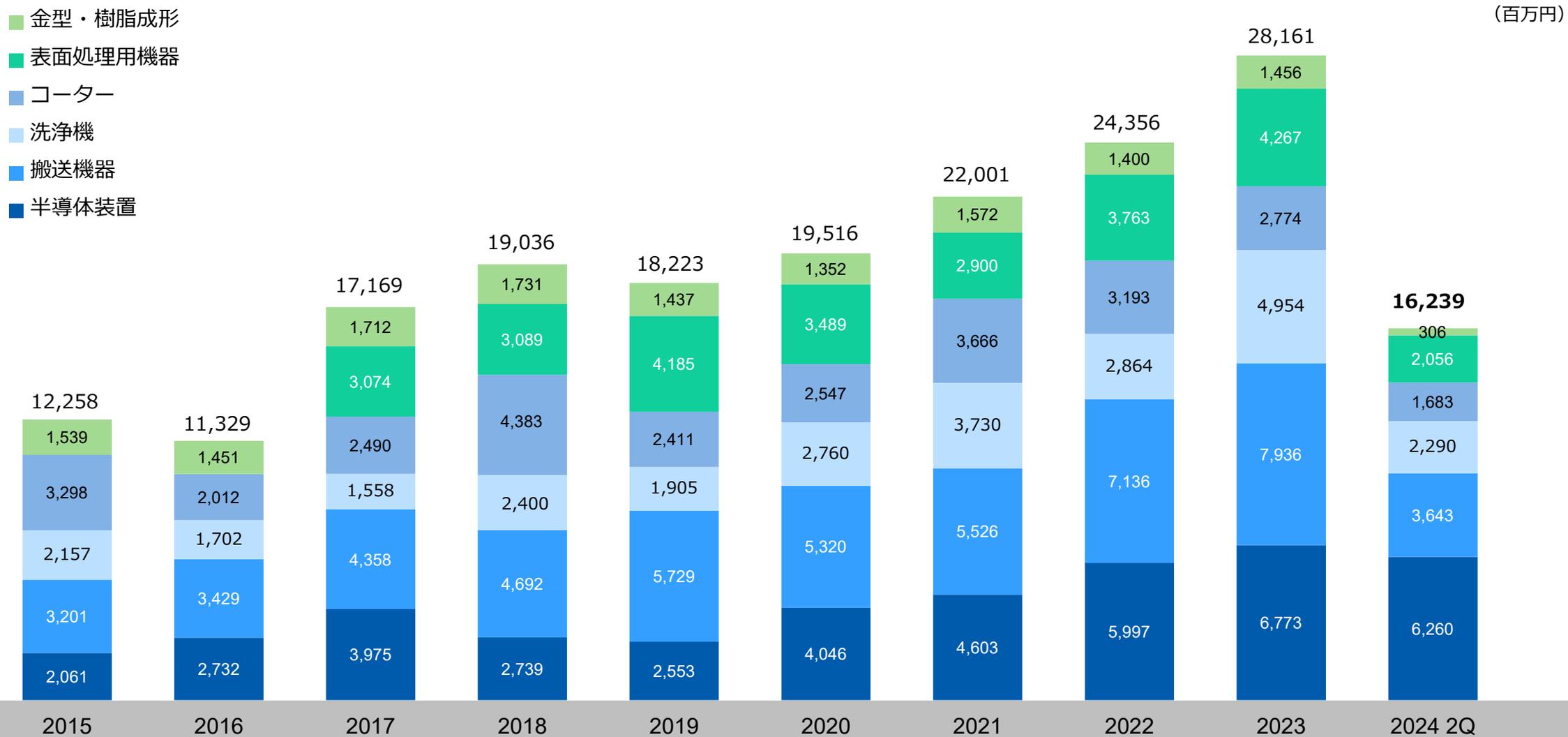
		2023年12月期 Q2 実績	2024年12月期 Q2 実績	前期比 増減率(%)	2024年12月期 計画	進捗率(%)	
		(百万円)					
プロセス機器事業	売上高	7,857	13,877	76.6	27,770	50.0	
	営業利益	703	2,745	290.3	4,250	64.6	
	■ 半導体装置	売上高	1,731	6,260	261.5	11,500	54.4
	■ 搬送機器	売上高	3,964	3,643	△8.1	8,100	45.0
	■ 洗浄機	売上高	1,640	2,290	39.6	5,800	39.5
■ コーター	売上高	520	1,683	223.3	2,370	71.0	
金型・樹脂成形事業	売上高	769	306	△60.3	1,700	18.0	
	営業利益	17	△101	—	30	—	
表面処理用機器事業	売上高	1,807	2,056	13.8	6,530	31.5	
	営業利益	△139	177	—	320	55.3	
セグメント利益又は損失	営業利益	△41	15	—	—	—	
合計	売上高	10,434	16,239	55.6	36,000	45.1	
	営業利益	539	2,836	425.5	4,600	61.7	

セグメント別 売上高推移 (四半期)

(百万円)

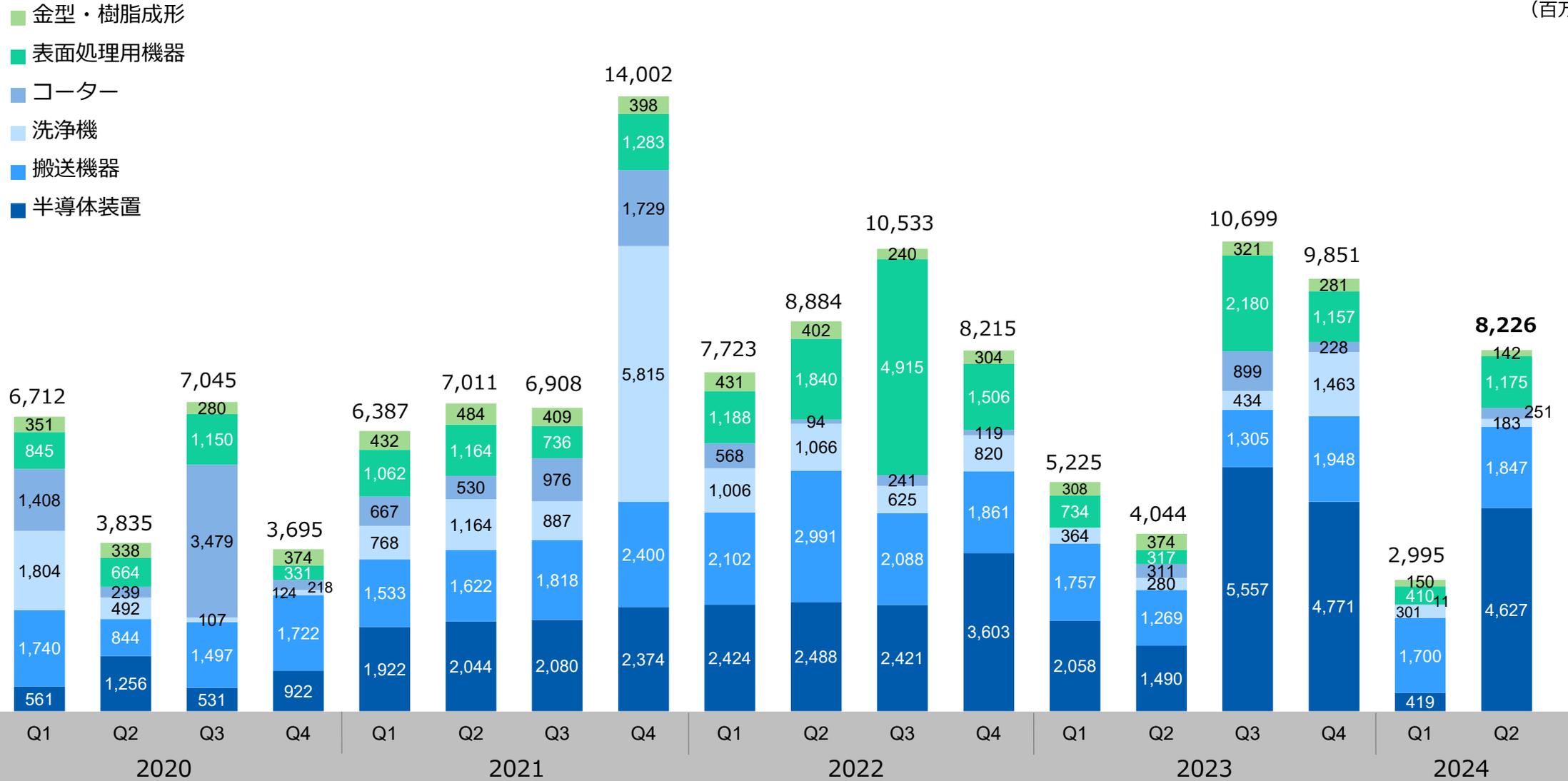


セグメント別 売上高推移 (通期)

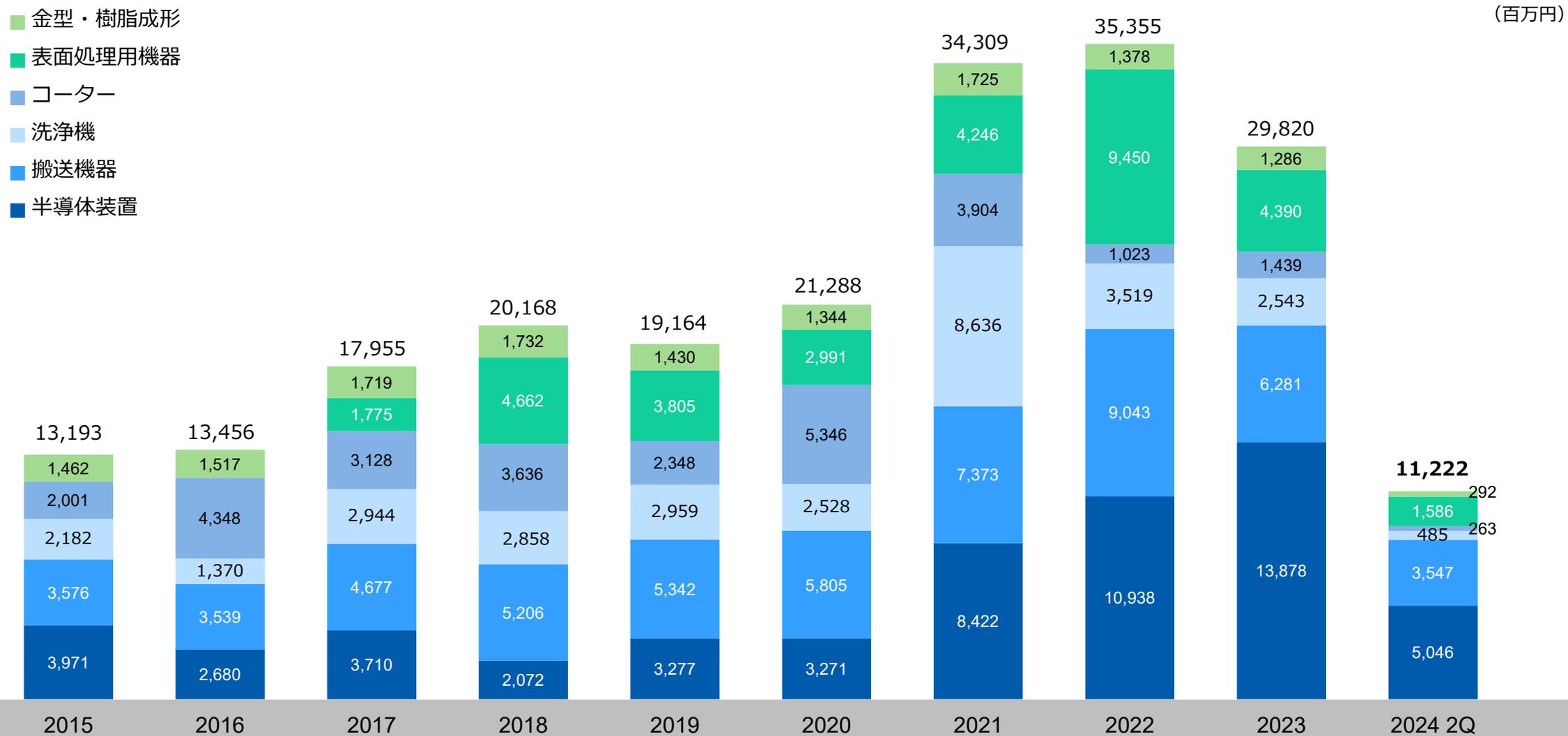


セグメント別 受注高推移 (四半期)

(百万円)



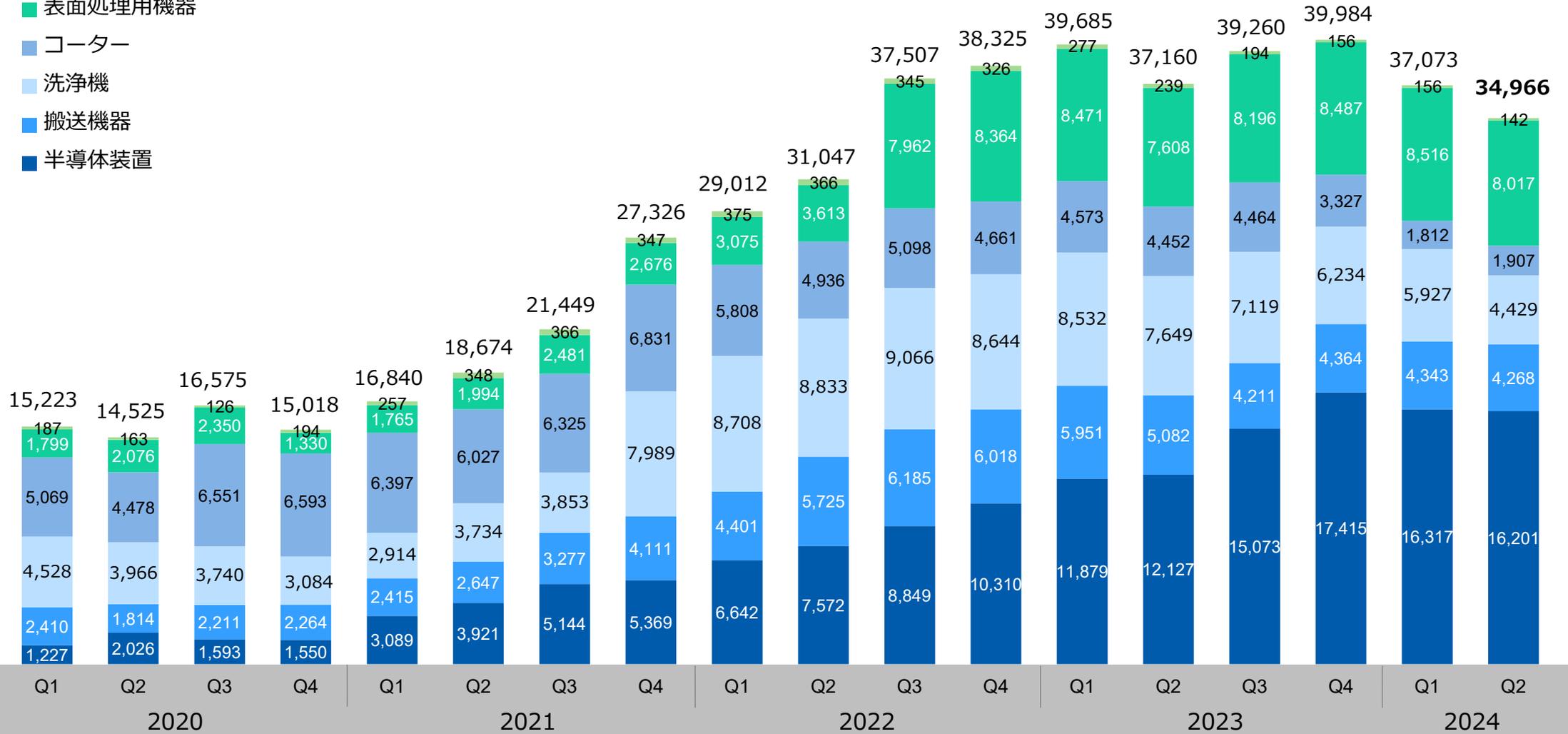
セグメント別 受注高推移 (通期)



セグメント別 受注残高推移

(百万円)

- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置





3

市場（顧客）の状況

- 半導体製造装置は、アドバンスドパッケージ向け装置でまとまった受注。時期は未定だが更なる投資の情報もあり、引き続き市場の拡大に期待している。パワー半導体向け装置については、引合いはあるものの投資時期が後ずれ傾向にある。パワー半導体の投資回復に備えて体制を強化。
- 搬送機器では中国からの受注は引続き堅調だが、国内ではメモリー／ロジックの市場状況の影響からか本格的な回復にはもう少し時間がかかりそう。
- スラリー供給装置の引合いが増えつつある。洗浄装置でも新規案件の話が少しずつ出てきている。確実に受注できるよう対応中。
- 台湾・中国を中心にPLP装置の引合が増加。確実に受注できるよう対応中。液晶パネル工場を半導体パッケージング用途に転用する動きが活発化している。今後の市場の拡大を期待している。
- 表面処理用機器は、めっき処理装置の投資計画の先送りなどもあり受注状況は一段落感がある。新規開発案件に注力しながら小口案件を受注するべく活動中。



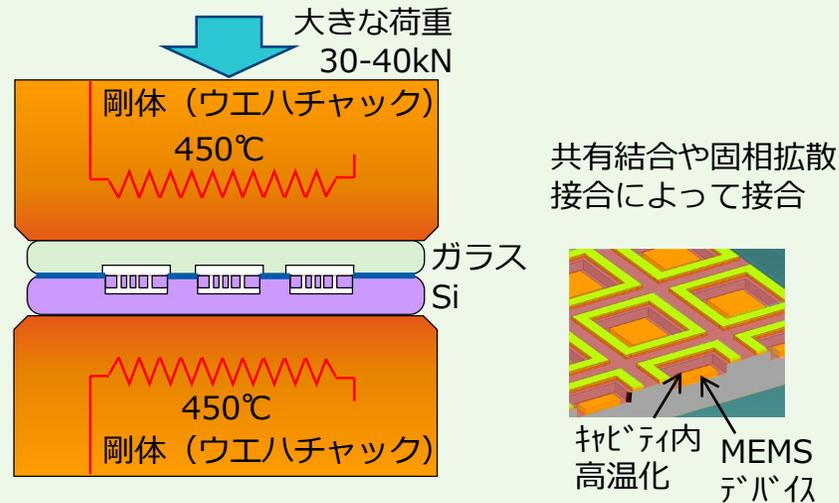
4

新技術紹介

MEMSデバイスの封止技術に対して、既存のプロセスでは解決が困難な課題に対して、新たにレーザーによる接合を開発しこれらの課題に対して有効なソリューションを提供します。

既存プロセス

ウエハ全体を加熱・加圧し、接合を行う

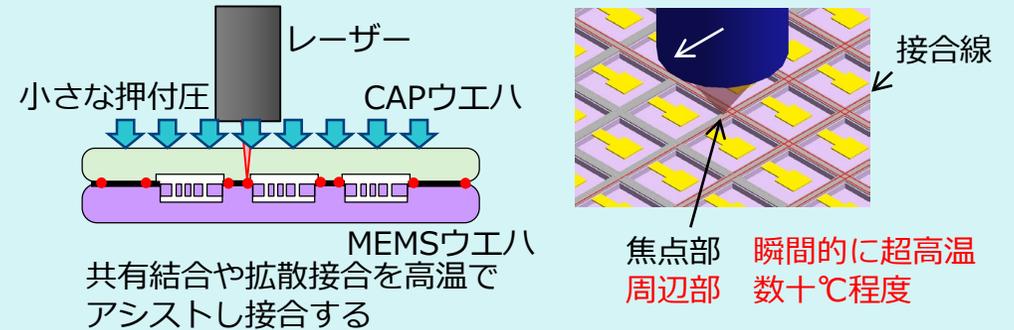


課題

- MEMSキャビティ全域が加熱される
 - 耐熱性が必要 → アウトガスが発生
 - 高真空が接合だけでは作り出せない
 - 接合の他に高真空化の方策が必要
- 熱膨張率が異なる材料では変形(反り)が生じる

新技術

レーザーにより局所的な加熱でウエハの接合を行う



メリット

- デバイス部を低温で接合が可能
- アウトガスが抑制でき、高真空封止が可能
- ウエハ全域で低温接合となり熱膨張率が異なる材料の接合が可能
- エネルギー効率がよく、低消費電力

ターゲット

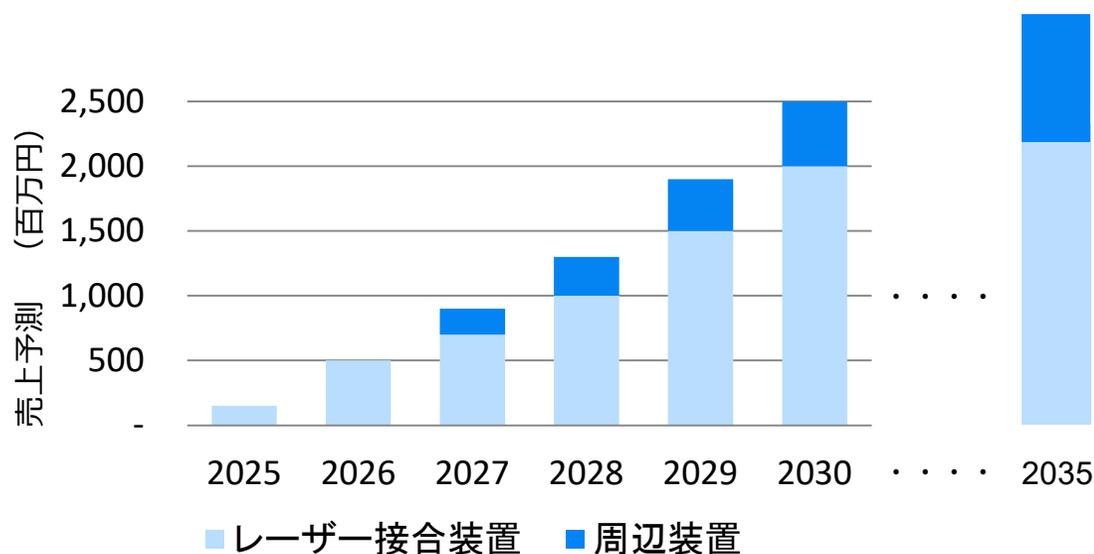
MEMSデバイス
ジャイロセンサ、赤外線センサ、
タイミングデバイス、
耐熱性が低いデバイス など

現状

実験機及び量産向け試作機を製
作り、協力会社、エンドユー
ザー様と接合の性能確認や信頼
性の評価を進めております。

本技術を開発するにあたり得られた知見、ノウハウ、技術を応用し、次世代技術（装置）を開発し、事業拡大を進めていきます。

当社の売上予測



接合装置を足掛けに周辺技術や、半導体デバイス関連に対しても新規装置を提案していく予定です。

MEMS market forecasts by end-market (Munits)
©Yole Intelligence, July 2023



引用：YOLE Status of the MEMS Industry 2023



5

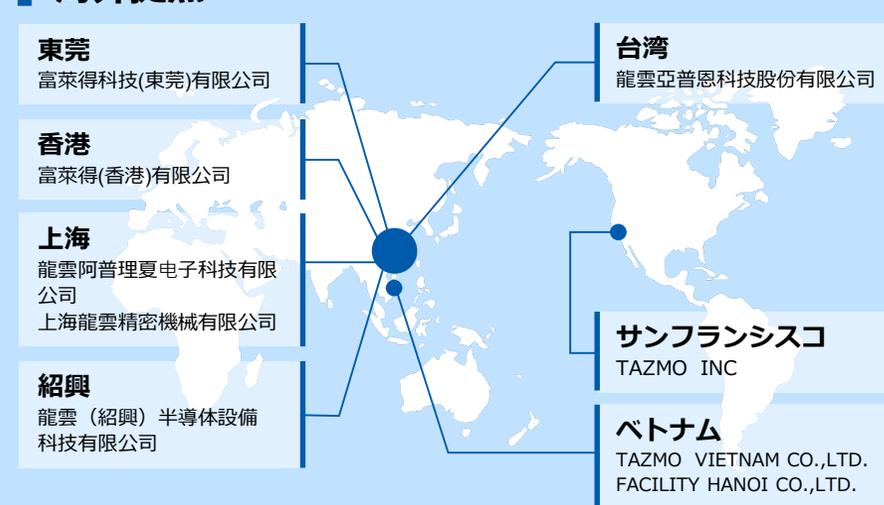
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	8,148名（2024年6月30日現在）
従業員数	単体 374名／連結 1,137名（2024年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

国内拠点・関連子会社



海外拠点



- 1972** ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980** ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989** ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990** ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994** ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995** ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001** ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、
- 製造・販売を開始
- 2004** ● - JASDAQ市場に株式を上場
- 2008** ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立
- 2009** ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
- 2013** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
- 2017** ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化
- 2018** ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更
- 2019** ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
- 2020** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
- 2022** ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フラットパネル製造装置を提供。現在はPLP用装置やナノインプリント装置の開発を進めている。



金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供



本資料の取扱上の注意

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp